

通富微电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324,534.90万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00405号《验资报告》验证。

2、2022年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的 512902062410666 号账户内131,000.00万元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的 32050164273600003056号账户内136,932.67万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267,837.21万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

（1）以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目231,698.50万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元；募集资金累计理财收益3,803.13万元，累计利息扣除手续费净额1,065.18万元；尚未使用的金额为2,189.82万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

本公司严控各项支出，节约了部分募集资金，同时募集资金存放期间产生利息净收入。因此，车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目实施出现募集资金结余2,189.82万元。本公司已将上述结余资金永久性补充流动资金，并已完成专户销户。

2、2022年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

（1）以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目9,847.52万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计利息扣除手续费净额494.34万元；尚未使用的金额为178,392.28万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投资项目51,148.26万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月12日经本公司第七届董事会第二十八次会议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
通富微电	招商银行南通分行	512902062410112	募集资金专户	已销户
南通通富	国开银行江苏分行	32101560028267790000	募集资金专户	已销户
通富微电	建设银行南通崇川支行	32050164273600002187	募集资金专户	已销户
通富微电	中国银行南通分行	467675385217	募集资金专户	已销户
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区分行	484575451753	募集资金专户	已销户
通富微电	工商银行南通分行	111182229100678068	募集资金专户	已销户
合 计				

说明：本公司2020年度非公开发行募集资金项目已结项，结余资金已用于永久性补充流动资金，所有专户余额为零，以上募集资金专户不再使用。根据《募集资金三方监管协议》，本公司已办理完毕以上募集资金专户的注销手续，与相关方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2022年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
南通通富	工商银行南通分行	1111822229100755187	募集资金专户	290,468,643.90
通富微电	建设银行南通崇川支行	32050164273600003056	募集资金专户	已销户
通富微电	招商银行南通分行	551905209810666	募集资金专户	已销户
通富微电	中国银行南通分行	548278415101	募集资金专户	162,823.13
通富微电	建设银行	32050164273600003170	募集资金专户	551,703,810.62
通富微电	招商银行	512902062410558	募集资金专户	293,311,437.54
通富通科	建设银行	32050164273600003169	募集资金专户	50,340,089.59
通富通科	招商银行	513904958410566	募集资金专户	40,530,263.73
合 计				1,226,517,068.51

说明：

(1) 上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益813.21万元（其中2023年度理财收益813.21万元）、募集资金专户利息收入2,707.13万元（其中2023年度利息收入2,212.65万元），已扣除手续费3.09万元（其中2023年度手续费2.95万元）。

(2) 上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为本公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。

变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年，本公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

通富微电子股份有限公司董事会

2024年4月12日

2023 年度募集资金使用情况对照表

1、2020 年度非公开发行募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		324,534.90		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				327,213.40		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
车载品智能封装测试中心建设	否	103,000.00	103,000.00		105,450.08	102.38	2022 年 12 月	3,795.70	否	否
集成电路封装测试二期工程	否	145,000.00	76,020.00		76,061.79	100.05	2022 年 6 月	2,152.18	否	否
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	否	50,000.00	50,000.00		50,186.63	100.37	2022 年 6 月	5,181.06	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	102,000.00	95,514.90		95,514.90	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	400,000.00	324,534.90		327,213.40	—	—	11,128.94	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受全球宏观经济承压、全球半导体市场疲软、行业周期波动影响，消费电子市场持续低迷，本期募投项目车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司 2020 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至 2020 年 10 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为 48,194.76 万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2020）第 110ZA09948 号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目实施出现募集资金结余 2,189.82 万元。产生结余，主要是由于公司严控各项支出，节约了部分募集资金，同时募集资金存放期间产生利息净收入。结余资金已永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2023 年度募集资金使用情况对照表

2、2022 年度非公开发行募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		267,837.21	本年度投入募集资金总额				51,148.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		141,650.00	已累计投入募集资金总额				141,182.99			
累计变更用途的募集资金总额		141,650.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		52.89%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能计算产品封装测试产业化项目	否	82,856.00	46,000.00	14,318.33	17,692.63	38.46	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
微控制器（MCU）产品封装测试项目	是	78,000.00	78,000.00	10,485.24	12,050.60	15.45	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
功率器件产品封装测试项目	是	63,650.00	63,650.00	26,344.69	31,252.55	49.10	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	165,000.00	80,187.21		80,187.21	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	389,506.00	267,837.21	51,148.26	141,182.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，同意公司将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。本公司以该部分募集资金向通富通科增资及提供借款，用于本次变更后的募投项目。借款期限自实施借款之日起，至相关募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可滚动使用，也可提前偿还，借款利率不超过银行同期贷款利率，借款到期后，可视通富通科实际经营情况，继续借予通富通科滚动使用。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	同上
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对截至2022年10月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为9,847.52万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2022）第110A017033号报告予以验证。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过15亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内15亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。</p> <p>经本公司2023年10月24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过9亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内9亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。</p> <p>2023年末，本公司使用募集资金进行现金管理无余额。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

2022 年度非公开发行募集资金项目变更情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
微控制器 (MCU) 产品封装测试项目	5G 等新一代通信用产品封装测试项目	78,000.00	10,485.24	12,050.60	15.45	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
功率器件产品封装测试项目	功率器件封装测试扩产项目	63,650.00	26,344.69	31,252.55	49.10	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	141,650.00	36,829.93	43,303.15	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>(1) 2022 年以来，国内外半导体封测产业的市场需求发生一定程度的分化。部分领域，如手机等消费电子芯片的封测需求随下游市场增长放缓而有所减少，部分应用领域如智慧物联网市场需求依然不断提升。在公用级物联网、工业级物联网、消费级物联网、车联网等方面，对 MCU 的需求方兴未艾。公司将“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”变更为“微控制器 (MCU) 产品封装测试项目”主要系公司适应市场环境的变化，聚焦于市场前景广阔的细分领域，提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力。</p> <p>(2) 公司将“功率器件封装测试扩产项目”变更到子公司通富通科实施，主要系考虑到公司各生产主体之间的产能优化配置、更好的发挥规模效应，提升募集资金的使用效率。</p> <p>(3) 2023 年 1 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》；2023 年 1 月 19 日，本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，同意公司将“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器 (MCU) 产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为公司控股子公司通富通科 (南通) 微电子有限公司。</p>						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用